



中华人民共和国国家标准

GB/T 24300—2009

铜钨电触头缺陷检测方法

Test method of flaws of Cu-W contact

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铜钨电触头缺陷检测方法

GB/T 24300—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

*

书号: 155066·1-39425

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会(SAC/TC 228)归口。

本标准负责起草单位:温州宏丰电工合金有限公司、桂林金格电工电子材料科技有限公司、桂林电器科学研究所。

本标准参加起草单位:辽宁金昌新材料有限公司、中希合金有限公司、陕西斯瑞工业有限责任公司、温州聚星银触点有限公司。

本标准主要起草人:陈晓、陈乐生、吴文安、郑元龙、王小军、谢永忠、杨清、赵俊、马大号、陈京生。

铜钨电触头缺陷检测方法

1 范围

本标准规定了用渗透探伤检测铜钨电触头的裂纹、孔洞和局部疏松以及铜钨整体电触头的界面裂纹和夹杂物、铜端裂纹和气孔等常见缺陷的方法。

本标准适用于对铜钨电触头和铜钨整体电触头开放性缺陷的检测。

本标准不适用于对铜钨电触头和铜钨整体电触头封闭性缺陷的检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JB/T 9218—2007 无损检测 渗透检测

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

铜钨裂纹 crack at Cu-W alloy

在制造时，铜钨合金受外力或内部组织应力形成的裂纹。

3.2

铜钨孔洞 void inside Cu-W alloy

在熔渗铜时，铜钨合金内部组织中的夹杂物挥发后残留的孔洞。

3.3

铜钨疏松 porosity inside Cu-W alloy

在熔渗铜时，铜钨合金内部组织未完全熔渗透而形成的多孔疏松组织。

3.4

界面裂纹 interface crack between Cu-W alloy and Cu part

在烧结(或焊接)时，铜钨整体触头的铜钨合金与铜端的结合界面存在氧化层或夹杂物层而形成的裂纹。

3.5

界面气孔 interface pore between Cu-W alloy and Cu part

在烧结时，铜钨整体触头冷却凝固析出气体在铜钨合金与铜端的结合界面形成的小孔洞。

3.6

铜端裂纹 crack at Cu part

在烧结(或焊接)时，铜钨整体触头的铜端内部组织存在氧化层或夹杂物层而形成的裂纹。

3.7

铜端疏松 porosity inside Cu part

在烧结时，铜钨整体触头的铜端冷却凝固偏析而形成的内部多孔疏松组织。